

2021年4月27日

ICパッケージ基板向け設備投資計画に関するお知らせ

当社におきましては、サーバー、画像処理などを中心とした、旺盛な顧客需要に対応するため、ICパッケージ基板の生産能力増強を図る目的で、河間事業場において以下内容の設備投資計画を策定いたしましたので、お知らせいたします。

【設備投資計画の概要】

1. 目的：高機能 IC パッケージ基板の生産能力増強
2. 総投資額：1,800 億円(予定)
3. 場所：河間事業場（岐阜県大垣市河間町 3-200）
4. 稼働時期：2023 年度より順次稼働し、量産開始の計画
5. 生産能力：本件投資により、2023 年度以降の IC パッケージ基板需要に対応可能な国内生産能力の増強を実施
6. スケジュール：

2021 年度上期	既存建物・設備等の解体撤去開始
2021 年度下期	新棟建設工事の開始
2023 年度	新棟竣工及び量産稼働開始



河間事業場 新棟竣工イメージ

【本件に関するお問合せ先】

経営企画部 経営企画グループ

担当：廣瀬・水谷

電話番号 0584-81-7973